

**OMNIMATE Data - Jack USB
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bus seriale universale 2.0 e 3.0 (SuperSpeed); i connettori di tipo A soddisfano i requisiti per l'alta resistenza e offrono una connettività affidabile.

- Fino a 5000 cicli d'innesto
- Processi di saldatura THT, THR o SMD
- Disponibile nella forma a 180° (verticale/verso l'alto) o a 90° (orizzontale/disteso)
- Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
- Lato dorato rinforzato per una migliore protezione dalla corrosione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL
Nr.Cat.	1549730000
Versione	Connettore per circuito stampato, Jack USB, Collegamento a saldare THT/THR, 2.00 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3 mm, Oro su nichel, blu, Vassoio (montaggio manuale)
GTIN (EAN)	4050118356083
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	Vassoio (montaggio manuale)

**OMNIMATE Data - Jack USB
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	14,65 mm	Larghezza (pollici)	0,577 inch
Posizione verticale	18,9 mm	Altezza (pollici)	0,744 inch
Altezza minima	14,95 mm	Profondità	7,1 mm
Profondità (pollici)	0,28 inch	Peso netto	2,46 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1,5 A	Resistenza contro l'isolamento	≥ 1000 MΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	100 V AC	Tensione nominale	30 V

Specifiche di sistema

Angolo di uscita	180°	Cablaggio	Tipo A, USB 3.0
Cicli di inserimento	≥ 1500	Diametro foro di equipaggiamento (D)	0,7 mm
Famiglia prodotti	OMNIMATE Data - Jack USB	Grado di protezione	IP20
LED	No	Linguette di schermatura	nessuno
Lunghezza spina a saldare (l)	3 mm	Materiale della schermatura	Ottone
Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT/THR	Numero di codoli a saldare per polo	1
Numero di poli	8	Passo in mm (P)	2 mm
Schermatura	Sì	Superficie di schermatura	nichelato
Tipo di collegamento	Femmina	Velocità di trasmissione	5 Gbps

Dati del materiale

Materiale isolante	LCP	Colori	blu
Tabella dei colori (simile)	RAL 5012	Gruppo materiali isolanti	II
CTI	≥ 500	Resistenza contro l'isolamento	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base dei contatti	Fosforo bronzo	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Struttura a strati del connettore maschio	30-80 µ" Ni / 30- µ" Au	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

Imballaggio

Imballaggio	Vassoio (montaggio manuale)	Lunghezza VPE	0 m
Larghezza VPE	0 m	Altezza VPE	0 m

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Data di creazione 12 giugno 2019 7.43.25 CEST

**OMNIMATE Data - Jack USB
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici

[STEP](#)

Documentazione utente

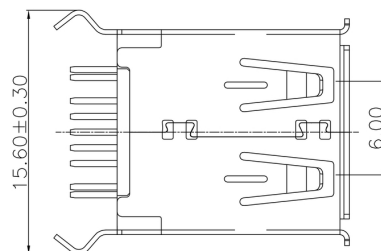
[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

**OMNIMATE Data - Jack USB
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

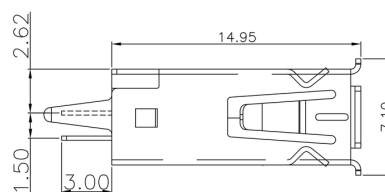
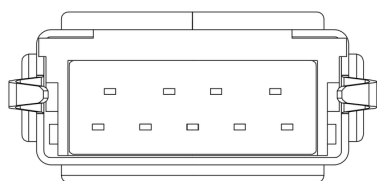
Disegni

Disegno quotato



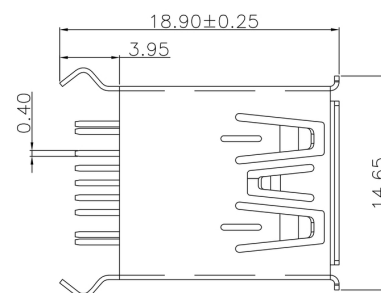
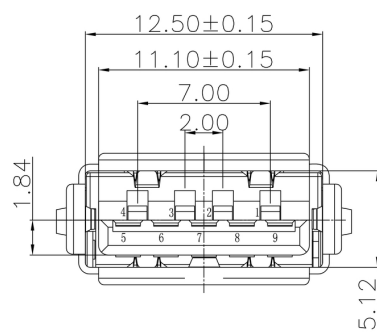
Disegno quotato

Disegno quotato



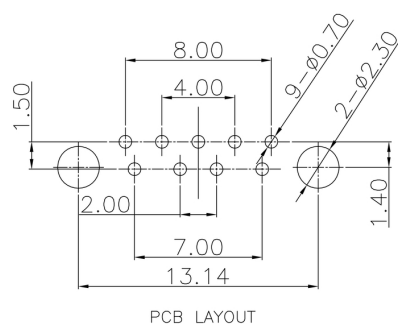
Disegno quotato

Disegno quotato



**OMNIMATE Data - Jack USB
USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno del circuito stampato**

OMNIMATE Data - Jack USB

USB3.0A R1V 3.0N2 TY BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Disegni

Legenda

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.